



Tagesordnung (Vorläufig)

Thema: 73. Treffen des Arbeitskreises
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und
Verbindungstechnologien“

Datum: **27. Oktober 2021, 10.00 Uhr**

Ort: Fraunhofer IZM, Berlin
Online via MS Teams

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung
Herr Dr. Walter, Fraunhofer IZM, Berlin
- 2 10:10 Uhr
Methoden und Messtechnik zur thermischen Charakterisierung und Fehleranalyse
Herr T. von Essen, Berliner Nanotest und Design GmbH, Berlin
- 3 10:50 Uhr
Thermisch und elektrisch leitfähige Klebstoffe – flexibel in der Anwendung, stabil im Verbund
Herr Dr. Fauser, Panacol-Elosol GmbH, Steinbach (Taunus)
- 4 11:30 Uhr
Development of a lifetime model for the new Die Top System Technology (DTS®) in combination with numerical Designs of Experiments (DOE)
Herr Dr. Fabian, Heraeus Deutschland GmbH & Co KG, Hanau
- 5 12:10 Uhr
Mittagspause

- 6 13:00 Uhr
Roadmap der europäischen Leiterplatten-Technologie und die wichtigsten Zukunftstrends
Herr Fiehler, KSG GmbH, Gornsdorf
- 7 13:40 Uhr
Simulationsmethoden zur Schadensbestimmung von Durchkontaktierungen aufgrund von kombinierten (elektro-thermo-mechanischen) Belastungen
Herr Prof. Abali, Uni Uppsala, Schweden
- 8 14:20 Uhr
(Kaffee-) Pause
- 9 14:30 Uhr
Untersuchungen von Laser-Material Wechselwirkungen und Laser-Induzierten Schäden in Dünnschicht-Solarzellen
Herr Dr. Schulz, HTW-Berlin; Berlin
- 10 15:10 Uhr
Verarbeitbarkeit und Zuverlässigkeit von Direct-Immersion-Gold (DIG) für Au- und AlSi1-Dünn-Drahtbondverfahren
Herr Fischer, Fraunhofer IZM, Berlin
- 11 15:50 Uhr
Abschlussdiskussion
Herr Dr. Walter, Fraunhofer IZM, Berlin

Ende der Veranstaltung gegen 16:00 Uhr